

3EC-M3-VLP

- ・ロープロファイル電解銅箔であり、サブトラでのファインパターン形成に最適です。
Low profile copper foil, suitable for fine etching in the subtractive process.
- ・また、高張力であるため、薄箔でも取扱いが用意です。
High tensile strength, easy to handle thin foil.
- ・最薄で7 μ mまでラインナップしております。
From 7 μ m, we line up.

用途/Application

- ・半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package
- ・多層プリント配線板
/High Density Interconnect
- ・フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

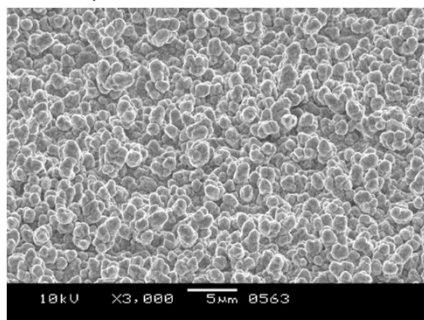
- ・日本 / Japan

代表的特性値/Representative data

	μ m	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-M3-VLP	9	80	2.8	500	4.0	0.9
	12	107	3.0	500	5.0	1.2
	18	153	3.5	500	8.0	1.4

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

